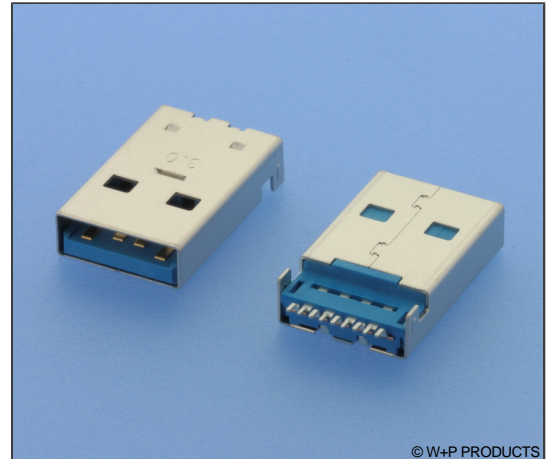


8290 (obsolete)

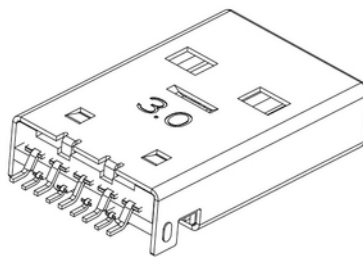
SMT USB 3.0 Steckverbinder, Typ A, Stecker liegend
SMT USB 3.0 Connectors, Type A, Plug Horizontal

Technische Daten / Technical Data

Gehäuse	Kupferlegierung, vernickelt
Shell	Copper alloy, nickel plated
Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0, blau
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0, blue
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Oberfläche Lötanschluss	Verzinkt
Plating Solder Side	Tin plated
Durchgangswiderstand	< 30 m Ω VBUS/GND im Auslieferungszustand < 50 m Ω im Auslieferungszustand
Contact Resistance	< 30 m Ω VBUS/GND initially < 50 m Ω initially
Isolationswiderstand	> 100 M Ω
Insulation Resistance	> 100 M Ω
Spannungsfestigkeit	100 V AC
Test Voltage	100 V AC
Nennspannung	30 V RMS
Voltage Rating	30 V RMS
Nennstrom	1,8 A VBUS/GND, 0,25 A DATA
Current Rating	1.8 A VBUS/GND, 0.25 A DATA
Temperaturbereich	-30 °C ... +85 °C
Temperature Range	-30 °C ... +85 °C
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren
Processing	Reflow soldering



© W+P PRODUCTS

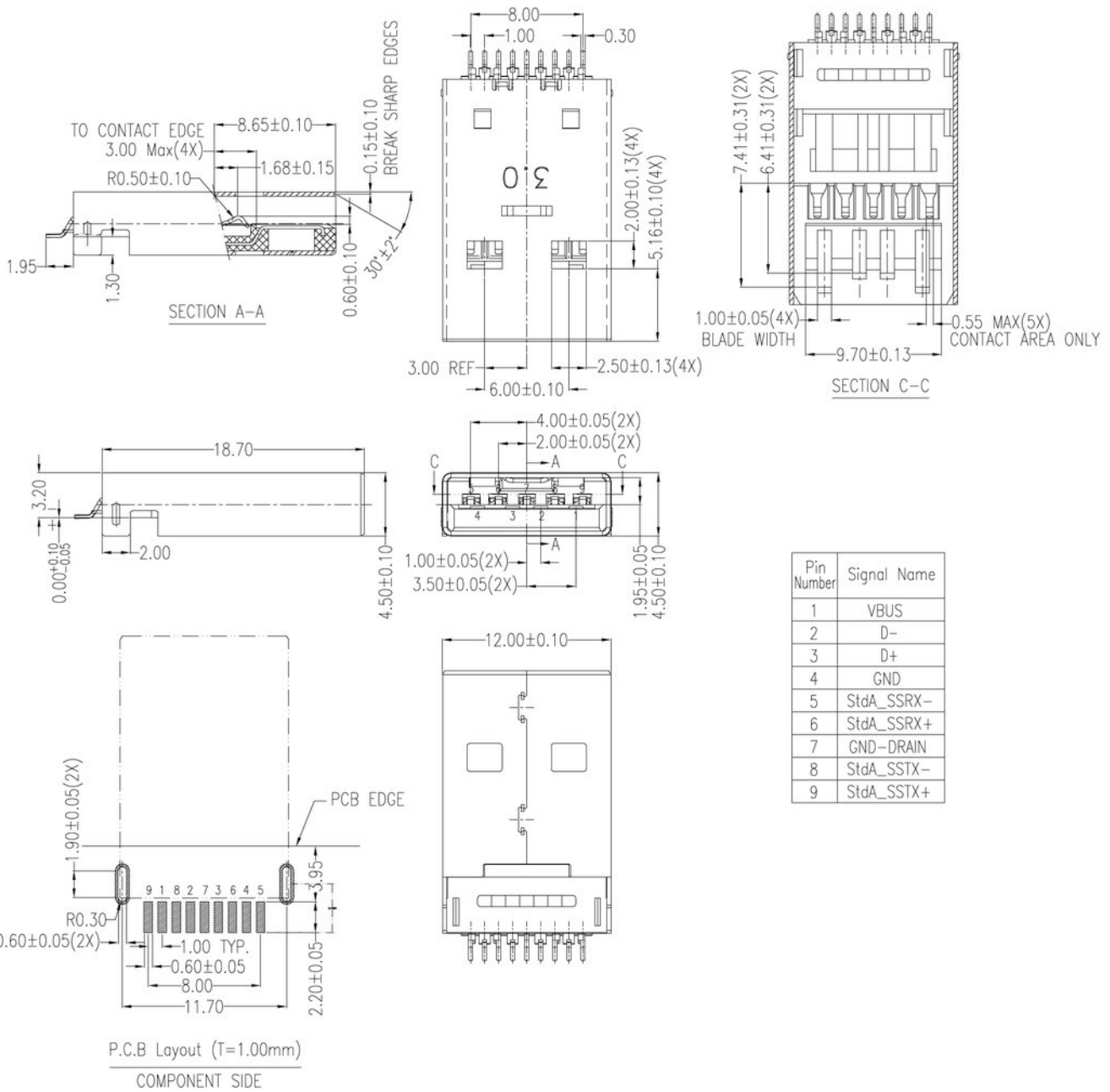


USB 3.0 Type A Male

8290-3-80-00

8290 (obsolete)

SMT USB 3.0 Steckverbinder, Typ A, Stecker liegend
SMT USB 3.0 Connectors, Type A, Plug Horizontal



Series

8290

Type

3

3 Type A Stecker
Type A male

Plating

80

80 Vergoldet 30µ"
30µ" gold plated

Package

00

00 Schüttgut
Bulk goods

Reflow-Lötempfehlung

Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Lötten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150 °C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich T_L	217 °C
Verweildauer oberhalb T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur T_P	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P	max. 8m

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150 °C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature T_L	217 °C
Duration above T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature T_P	260±5 °C
Duration Peak Temperature	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	max. 8min

